

关于组织召开“数字图像相关与非接触实验力学国际会议”的通知

中国·杭州

2018年10月15-18日

各有关单位：

数字图像相关与非接触实验力学国际会议（The International Conference on Digital Image Correlation and Noncontact Experimental Mechanics）将于2018年10月15-18日在杭州召开，此次会议由浙江大学建筑工程学院、国际数字图像相关协会（International Digital Image Correlation Society, iDICs, USA）以及国际实验力学学会（Society for Experimental Mechanics, SEM, USA）联合主办，由浙江大学建筑工程学院罗尧治院长、国际数字图像相关协会主席 Michael Sutton 教授以及国际实验力学学会主席 Kathryn Dannemann 教授共同担任大会联合主席。

杭州是全国著名的5A级旅游城市，具有秀丽的自然风光、丰富的人文景观和深厚的文化内涵，G20金融峰会后的杭州更以崭新的面貌吸引了全世界的目光。

在此我们诚邀从事数字图像相关与非接触实验力学研究和技术开发的专家、同行以及在读研究生，积极投稿并相聚杭州，以全面展示近年来海内外学者在数字图像相关与非接触实验力学领域取得的最新进展与成就，进一步促进相关研究的发展和工程应用。

本次会议官网已经开通，详细内容请登录网址：<http://www.idics-sem2018.org/>

IDICS2018 欢迎您！杭州欢迎您！

一、大会主题报告人

- ◆ 于起峰（中国），中国科学院院士、国防科学技术大学教授（李璋教授代）
- ◆ Michael A. Sutton（美国），国际数字图像相关协会主席、南卡罗来纳大学教授
- ◆ 李惠（中国），国际结构控制与监测学会理事长、哈尔滨工业大学教授
- ◆ Yozo Fujino（日本），东京大学名誉教授、国立横滨大学特聘教授
- ◆ Billie F. Spencer, Jr.（美国），伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校首席教授
- ◆ Fabio Casciati（意大利），意大利帕维亚大学教授
- ◆ 倪一清（中国香港），香港理工大学教授
- ◆ 梁晋（中国），西安交通大学教授
- ◆ Necati Catbas（美国），中佛罗里达大学教授
- ◆ Hoon Sohn（韩国），韩国科学技术院教授
- ◆ 潘兵（中国），北京航空航天大学教授
- ◆ Pascal Lava（比利时），比利时鲁汶大学教授
- ◆ Nam-Seo Goo（韩国），韩国建国大学教授

二、会议组织机构

国际咨询委员会

联合主席：

Qi-Feng Yu National University of Defense Technology, China

Michael Sutton University of South Carolina, USA

Kathryn Dannemann Rensselaer Polytechnic Institute, USA

委员：

Helena Jin Sandia National Labs California, USA

Michael Keller The University of Tulsa, USA

Sharlotte Kramer	University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
Luciano Lamberti	Politecnico Di Bari, Brazil
Ming-Tzer Lin	National Chung Hsing University, Taiwan, China
Paul Reynolds	The University of Sheffield, UK
Jeff Peduzzi	Capacitec, Inc., France
R. Singh	Oklahoma State University, USA

国际学术委员会

联合主席：

Yao-Zhi Luo	Zhejiang University, China
Yuh J. Chao	University of South Carolina, USA
Phillip L. Reu	Sandia National Laboratories, USA

委员：

James M.W. Brownjohn	University of Exeter, UK
F. Necati Catbas	University of Central Florida, USA
Fabio Casciati	University of Pavia, Italy
Tommy H. T. Chan	Queensland University of Technology, Australia
Chih-Chen Chang	Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, China
Jin-Long Chen	Tianjin University, China
Samantha Daly	University of California, Santa Barbara, USA
David S. Dawicke	Analytical Services and Materials, Inc., USA
Shirley J. Dyke	Purdue University, USA
Jing Fang	Peking University, China
Lucia Faravelli	University of Pavia, Italy
Maria Q. Feng	Columbia University, USA
José L. F. Freire	Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, Brazil
Branko Glisic	Princeton University, USA
Xing-Long Gong	University of Science and Technology of China, China
Guang-Ping Guo	AECC Beijing Institute of Aeronautical Materials, China
Cun-Fu He	Beijing University of Technology, China
Xiao-Yuan He	Southeast University, China
Yu-Ming He	Huazhong University of Science and Technology, China
Xiao-Fang Hu	University of Science and Technology of China, China
Pei-Yan Huang	South China University of Technology, China
Mark Iadicola	National Institute of Standards and Technology, USA
Hyung-Jo Jung	Korea Advanced Institute of Science and Technology, Korea
Yi-Lan Kang	Tianjin University, China
Markus Klein	GOM GmbH, Germany
Hui Li	Harbin Institute of Technology, China
Xi-De Li	Tsinghua University, China
Zheng Li	Peking University, China
Christopher Niezrecki	University of Massachusetts Lowell, USA
Bing Pan	Beijing University of Aeronautics and Astronautics, China
Jean-Noël Périé	Institut Clément Ader, France

Hubert W. Schreier	Correlated Solutions, USA
Hoon Sohn	Korea Advanced Institute of Science and Technology, Korea
Billie F. Spencer	University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
R. N. Taylor	City, University of London, UK
W. Andy Take	Queen's University, Canada
Yichang Tsai	Georgia Institute of Technology, USA
Daniel Z. Turner	Sandia National Laboratories, USA
Kelvin C. P. Wang	Oklahoma State University, USA
Qing-Yuan Wang	Sichuan University, China
Wei-Chung Wang	National Tsing Hua University, Taiwan, China
Wei Wu	University of Natural Resources and Life Sciences, Austria
Zhi-Shen Wu	Ibaraki University, Japan
Hui-Min Xie	Tsinghua University, China
Xue-Feng Yao	Tsinghua University, China
Xiao-Wei Ye	Zhejiang University, China
Ting-Hua Yi	Dalian University of Technology, China
Ying Yu	Shantou University, China
Chung-Bang Yun	Zhejiang University, China
Dong-Sheng Zhang	Shanghai University, China
Qing-Chuan Zhang	University of Science and Technology of China, China

国际组织委员会

联合主席：

Chung-Bang Yun	Zhejiang University, China
Xiao-Wei Ye	Zhejiang University, China

委员：

Yue-Quan Bao	Harbin Institute of Technology, China
Sara Casciati	University of Catania, Italy
Young-Jin Cha	University of Manitoba, Canada
Chien-Chou Chen	National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, China
Zhi-Cong Chen	Fuzhou University, China
Zhi-Qiang Chen	University of Missouri, Kansas City, USA
Soo-Jin Cho	University of Seoul, Korea
Xue Feng	Tsinghua University, China
Jin-Yang Fu	Central South University, China
Wendy Flores-Fuentes	Universidad Autónoma de Baja California, Mexico
Yan-Lin Guo	Colorado State University, USA
Shinae Jang	University of Connecticut, USA
Yun-Feng Ji	Tongji University, China
Hai-Quan Jing	Central South University, China
Wan-Run Li	Lanzhou University of Technology, China
Zhan-Wei Liu	Beijing Institute of Technology, China
Qing Lü	Zhejiang University, China
Wei Lu	Harbin Institute of Technology (Shenzhen), China

Shao-Peng Ma	Beijing Institute of Technology, China
Zhu Mao	University of Massachusetts Lowell, USA
Zhen-Hua Nie	Jinan University, China
Bao-Hua Shan	Harbin Institute of Technology, China
Yan-Bin Shen	Zhejiang University, China
Sung-Han Sim	Ulsan National Institute of Science and Technology, Korea
Tao Suo	Northwestern Polytechnical University, China
Ye Tian	Zhejiang University, China
Shun Weng	Huazhong University of Science and Technology, China
Li-Jun Wu	Fuzhou University, China
Yan Xu	University of Exeter, UK
Feng Xu	University of Science and Technology of China, China
Yong-Chao Yang	Los Alamos National Lab-Engineering Institute, USA
Hyung-Chul Yoon	Michigan Technological University, USA
Jian Zhang	Southeast University, China
Jian-Guo Zhu	Jiangsu University, China

三、会议议程

星期一 (10月15日)	星期二 (10月16日)	星期三 (10月17日)	星期四 (10月18日)
课程授课	开幕式 主题报告	主题报告	主题报告
	主题报告	主题报告	主题报告 闭幕式
午餐	午餐	午餐	午餐
课程授课	分组报告	分组报告	西湖游船
		技术参观	
自助晚餐	欢迎晚宴	晚餐	

其中 10 月 15 日邀请了来自美国和欧洲的专家学者进行数字图像相关 (DIC) 课程授课 (具体内容见本文件最后的相关课程介绍, 全天课程费用 1000 元人民币), 课程注册缴费网址: <http://www.idics-sem2018.org/show.asp?navid=6>

四、赞助参展商

金牌赞助	
Correlated Solutions (美国)	GOM GmbH (德国)
银牌赞助	
MTS Systems China Ltd. (美特斯工业系统(中国)有限公司)	

铜牌赞助	
Image Systems (瑞典)	Specialised Imaging Limited (英国)
EikoSim (法国)	上海活图隆公司
Vision Research (阿美特克集团) (美国)	北京欧兰科技发展有限公司
MatchID (比利时)	NAC Image Technology Inc. (日本)
Seika Digital Image (日本)	Psylotech (北京睿拓时创科技有限公司)
iX Cameras (美国)	HOLO3 (法国)
TELOPS (加拿大)	新拓三维技术(深圳)有限公司

五、会议召开时间及地点

时间：2018年10月15-18日

地点：杭州望湖宾馆（距离西湖步行约2分钟）

六、会议注册

- 9月15日之前（含15日）：

正式代表：3800元/人

学生：1600元/人

- 9月15日之后：

正式代表：4100元/人

学生：1900元/人

会议注册费包含会议期间餐费、资料费、会议费等。住宿费和差旅费自理。

在线注册及缴费请通过会议官网进行（<http://www.idics-sem2018.org/>）。

七、会议联系人

叶肖伟 15857113136, 邮箱: cexweye@zju.edu.cn

金涛 18868108071, 邮箱: cetaojin@zju.edu.cn

友情提醒： 尚未注册的参会代表可以尽快到会议网站注册缴费（<http://www.idics-sem2018.org/show.asp?navid=6>）。另外，会议网站也开通了酒店预订功能（<http://www.idics-sem2018.org/show.asp?navid=11>），房源有限，尽早预订，感谢大家对本次会议的大力支持！

